

客户 CUSTOMER: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书 SPECIFICATION

Preliminary

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式双工器

Multilayer Chip Diplexer

贵 司 料 号 YOUR PART NO.: _____

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MDPX18M2455P69-D06E

版 本 号 VERSION.: V1.0

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:
DATE:公司:
COMPANY:

批准

CFMD

审核

CHKD

接收

RCVD

本纳入仕様书共 7 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD

TEL: 86-755-28085000

FAX: 86-755-28085605

CFMD.

批准

CHKD.

审核

DSGD.

担当

梁启新

付迎华

曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

1

纳入仕様书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	DATE	CONTENT	APPROVED
1.0	2020.08.03	初稿 Constitute	梁启新

目录 CATALOG

1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.....	4
4 测试条件 Testing Conditions.....	5
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.....	9

1 适用范围 Scope

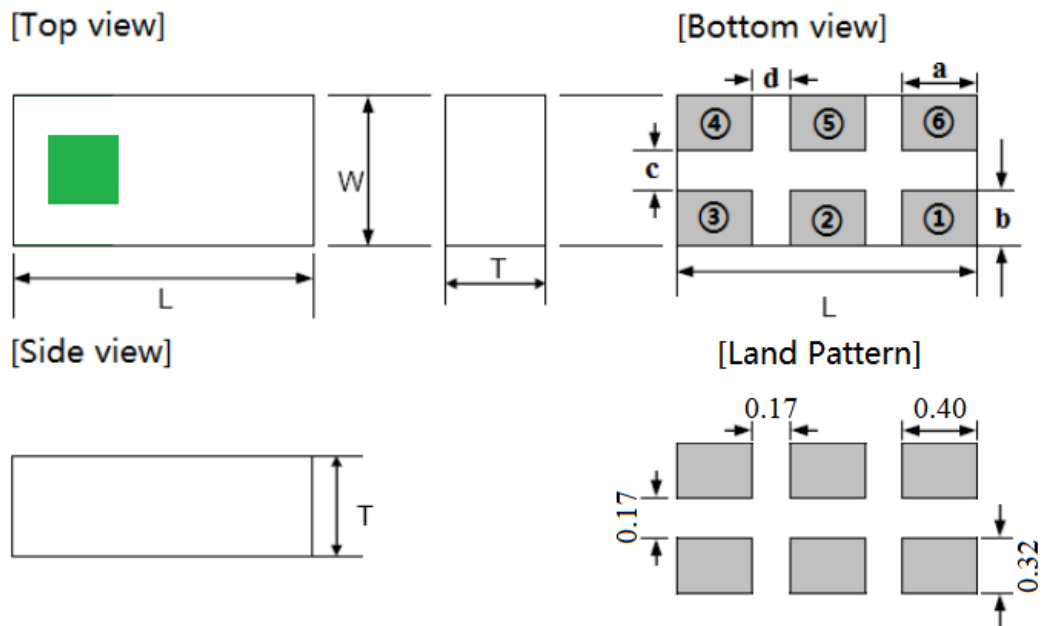
“麦捷”叠层片式双工器系列产品设计用于 PHS、WLAN、GSM、Bluetooth、PDA 和无绳电话机中，具有低的插入损耗、高的衰减和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

“Microgate” Multilayer Chip Diplexer series are designed to be used in PHS, WLAN, GSM, Bluetooth, PDA & Cordless phones with low insertion loss and high attenuation as well as small size SMD chip design, which can simplify your complex tuning and circuit design.

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



PIN Configuration

①	②	③	④	⑤	⑥
Low-Band	GND	High-Band	GND	Common Port	GND

Dimension

Unit: mm

L	W	T	a	b	c	d
1.6±0.1	0.8±0.1	0.6±0.1	0.39±0.1	0.29±0.1	0.22±0.1	0.215±0.1

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

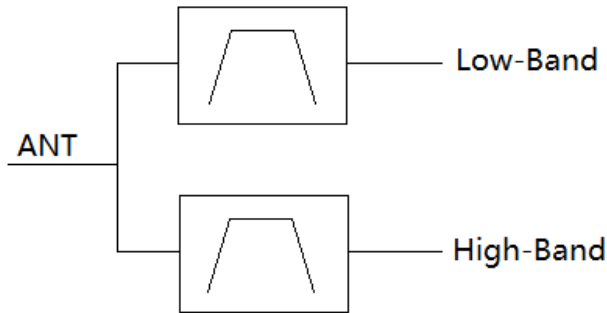
地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

Circuit Diagram



4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (-40 to 85℃)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃

No.	Item (项目)		Specifications (特性)		
			Min.	Typ.	Max.
5.1	Frequency Range 频率范围(f1)		2400~2500 MHz		
	Frequency Range 频率范围(f2)		4900~5950 MHz		
5.2	Insertion Loss 插入衰耗 (2400~2500MHz)	+25℃		0.62 dB	0.75dB
		-40 to +85℃			0.9dB
5.3	Insertion Loss 插入衰耗 4900~5100MHz	+25℃		1.12 dB	1.5dB
		-40 to +85℃			1.7 dB
	Insertion Loss 插入衰耗 5150~5950MHz	+25℃		0.91dB	1.2 dB
		-40 to +85℃			1.4 dB
5.4	Return loss	2400~2500MHz	13dB	23.8dB	
		4900~5150MHz	13dB	17.4dB	
		5150~5950MHz	13dB	20.9dB	
5.5	Attenuation 阻带衰耗 (in f1)	1200~1250MHz	10dB	17.1dB	
		1570~1600MHz	10dB	16.3dB	
		4800~6000MHz	25dB	30.8dB	
		7200~7500MHz	25dB	29.4dB	
		9600~10000MHz	25dB	42dB	

5.6	Attenuation 阻带衰耗 (in f2)	1610~2000 MHz	25dB	31.6dB	
		2400~3000 MHz	27dB	32dB	
		3300~3800 MHz	30dB	35dB	
		9800~12000MHz	20dB	28.1dB	
		14200~18000MHz	20dB	26.4dB	
5.7	Isolation 隔离度	2400~2500 MHz	30dB	32.5dB	
		4800~6000MHz	25dB	33.0dB	
		15000~18000MHz	20dB	22.7dB	
5.8	In/Output Impedance 输入/输出阻抗		50 Ω		
5.9	Power Capacity		2W Max.		

6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

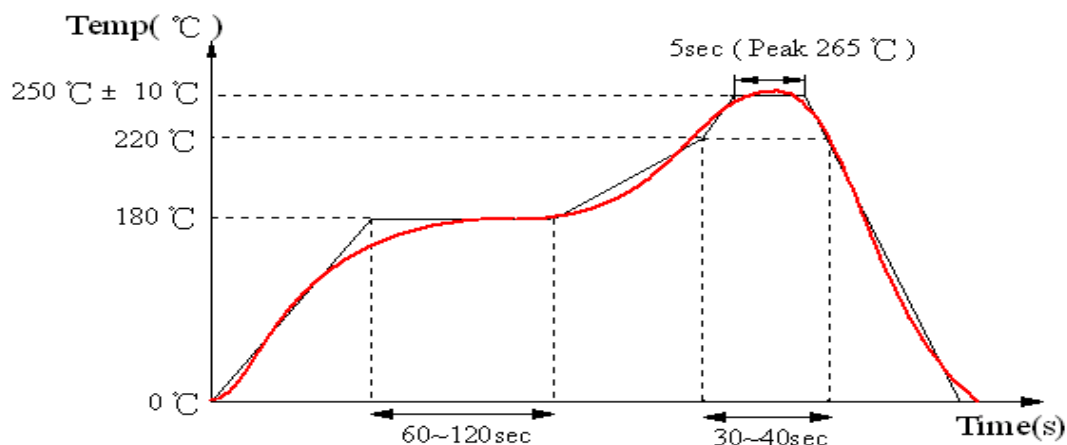
② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

● 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

● 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150℃, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	350℃ max
输出功率 Soldering iron output	80w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max